



Principales

Gamme de produit	Modicon M580
Type de produit ou équipement	Module processeur redondant
Technologie d'isolation	Double vernissage

Complémentaires

Nombre de racks	1
E/S spécifiques de l'application	Horodatage haute précision HART Compteur Codeur SSI Liaison série Contrôle de mouvement
Vérifications	Contrôle de processus
Canaux de contrôle	Boucles programmables
Type de connexion intégrée	1 Ethernet TCP/IP pour port service 2 Ethernet TCP/IP pour réseau équipements USB type mini B 1 Ethernet pour port HSBY
Nombre de stations d'E/S distantes	16 - 2 rack(s) par racks X80 et Quantum
Nombre d'équipements distribués	64
Capacité du module de communication du processeur	8 Module AS-i 4 module de communication Ethernet
Service de communication	Scanner DIO Scanner RIO
Description de la mémoire	Extensible flash, 4 GB pour stockage de données Intégré RAM, 10 ko pour mémoire système Intégré RAM, 16 Mo pour programme Intégré RAM, 2048 ko pour données
Structure d'application	1 tâche fixe périodique 1 tâche maître cyclique/périodique
Nombre d'instructions par ms	30 Kinst/ms 65 % booléens et 35 % à virgule fixe 40 Kinst/ms 100 % booléens
Consommation électrique	360 mA à 24 V CC
Fiabilité MTBF	650000 H
Marquage	CE

Environnement

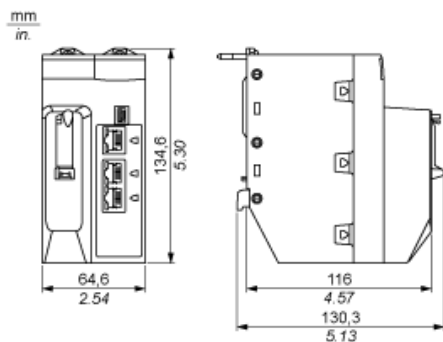
Tenue aux vibrations	3 gn
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m 2000...5000 m avec facteur de réduction

Humidité relative	5...95 % à 55 °C sans condensation
Degré de protection (IP)	IP20
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2014/34/EU - ATEX directive
Certifications du produit	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Marine marchande[RETURN]ATEX zone 2/22[RETURN]IECEx zone 2/22
Normes	EN/CEI 61131-2 EN/CEI 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/CEI 61000-6-5, interface type 1 et type 2 EN/CEI 61850-3, location G EN/CEI 60079-0
Caractéristique d'environnement	Résistant au gaz classe Gx se conformer à ISA S71.04 Résistant au gaz classe 3C4 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant à la poussière classe 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant au sable classe 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant au sel niveau 2 se conformer à CEI 68252 Résistant à la croissance des moisissures classe 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3 Résistant aux spores fongiques classe 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3 Zone dangereuse Classe I Division 2
Traitement de protection	Vernis de tropicalisation
Alimentation	Alimentation interne par le rack
Etat LED	1 LED (vert) processeur en marche (RUN) 1 LED (rouge) défaut processeur ou système (ERR) 1 LED (rouge) erreur de module E/S (E/S) 1 LED (vert) Téléchargement en cours (DL) 1 LED (rouge) panne carte mémoire ou flash CPU (BACKUP) 1 LED (vert/rouge) ETH MS (état de configuration du port de Ethernet) 1 LED (vert/rouge) Eth NS (état du réseau Ethernet) 1 LED (vert) processeur distant en marche (REMOTE RUN) 1 LED (vert) ID du processeur réglé à A (A) 1 LED (vert) ID du processeur réglé à B (B) 1 LED (vert) processeur agissant comme Primaire (PRIM) 1 LED (vert) processeur agissant comme Veille (STBY) 1 LED (vert) valeurs E/S forcées par l'utilisateur (FORCED IO) 1 LED (vert) état de lien mis en veille sous tension (Hsby Diag)
Poids du produit	0,849 kg

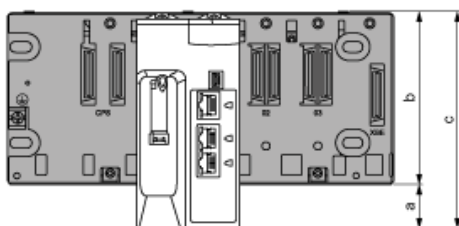
Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Module processeur seul

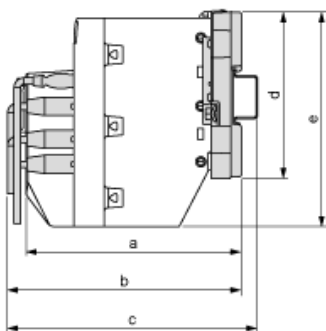


Modules montés dans des racks



- a : espace supplémentaire sous le rack pour tenir compte de la hauteur du processeur (CPU). Pour un rack X Bus : 30,9 mm (1,217 pouce); pour un rack Ethernet : 29,49 mm (1,161 pouce).
- b : hauteur du rack. Pour un rack X Bus : 103,7 mm (4,083 pouces); pour un rack Ethernet : 105,11 mm (4,138 pouces).
- c : hauteur du rack local principal = 134,6 mm (5,299 pouces)

Modules et câbles montés dans un boîtier



- a : profondeur du boîtier : 135 mm (5,315 pouces)
- b : profondeur câblage + module : > 146 mm (5,748 pouces)
- c : profondeur câblage + module + rail DIN : > 156 mm (6,142 pouces)
- d : hauteur de rack X Bus : 103,7 mm (4,083 pouces); hauteur de rack Ethernet : 105,11 mm (4,138 pouces)
- e : hauteur de module : 134,6 mm (5,299 pouces)